

平成13年度
営業報告

第83期

（平成13年4月 1 日から
平成14年3月31日まで）



株式会社 日立ハイテクノロジーズ

目 次

会 社 の 概 要	3
株主の皆様へ	4
トピックス	6
営 業 の 概 況	8
単 独 決 算	12
売上高の状況	15
過 去 の 推 移	16
株 式 の 状 況	18
連 結 決 算	20
ネットワーク	26
株 主 メ モ	27

表紙の写真

2002環境フォトコンテスト

(プレジデント社主催)

日立ハイテック/ロジーズ賞優秀賞受賞作品

「春が来た」 柳本真一郎氏撮影



印刷インキは大豆油インキを使用しております。

*このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

会社の概要

商 号	株式会社 日立ハイテクノロジーズ
本店所在地	東京都港区西新橋一丁目24番14号
設立年月日	昭和22年4月12日
資 本 金	7,938,480,525円(平成14年3月31日現在)
従 業 員	3,130名(平成14年3月31日現在)
役 員	(平成14年3月31日現在)
取締役会長	桑田 芳郎
代表取締役社長	樋口 紀昭
代表取締役専務取締役	実松 俊弘
代表取締役専務取締役	紀国 郁夫
常務取締役	角田 雄一
常務取締役	山下 勝治
常務取締役	中野 和助
常務取締役	脇野 和彦
常務取締役	大久保 征二
常務取締役	市川 憲幸
取締 役	興津 忠隆
取締 役	伊藤 巖
取締 役	大林 秀仁
取締 役	宮内 真澄
取締 役	金内 寛
取締 役	西村 康彦
取締 役	稲垣 昭久
監 査 役	木幡 恭彦
監 査 役	河智 徹
監 査 役	松香 茂道
監 査 役	三浦 一雄

監査役 松香茂道、三浦一雄は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。



株主の皆様には、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃の株主の皆様からのご支援とご理解に対しまして深く感謝申し上げますと共に、平成13年度（第83期）営業報告をお届けするにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

当年度の経営環境は、世界的なIT不況に伴い、日本をはじめ、欧米、アジア各国において景気減速が同時に進行するなど、非常に厳しい状況で推移致しました。

このような環境の中、当社は成長事業分野への経営資源の集中と、競争力ある新製品、及び新規事業の開発を進めて参りましたものの、半導体や情報通信分野の設備投資抑制等の影響により、半導体製造装置や光通信用部品の業績が大幅に低迷致しました。その結果、当年度（平成13年4月～平成14年3月）の業績は、売上高511,160百万円（前年度比11.8%減）、経常利益5,720百万円（同45.7%減）、当期純利益3,313百万円（同40.4%減）となりました。

さて、既に皆様もご存知のとおり、当社が平成13年10月1日に日製産業株式会社と株式会社 日立製作所の計測器グループ、半導体製造装置グループとの事業統合により、「株式会社 日立ハイテクノロジーズ」としてスタートしてから半年以上が経過致しました。

IT、バイオ、ナノテクノロジーなど時代の最先端を支える技術分野は常に激しく変化しており、当社は商社機能と設計・製造機能を有機的に結び付けることにより、半導体製造装置やバイオ関連製品をはじめとする最先端技術分野のニーズにスピーディに対応し、世界中のお客様から「選ばれる企業」になることを目標に掲げています。また、従来の商社機能につきましても、事業構想力やグローバルなマーケティング力・エンジニアリング力・ソフト力を更に活用・強化することにより、トータルソリューションビジネスの拡大に取り組んでおります。

当社は今後、市場成長が見込めると共に、当社の強みを活かせる「半導体」「情報・通信」「デジタルメディア」「ライフサイエンス」「環境」の重点5分野において、商社機能と製造機能の一体化に伴うシナジー効果を発揮すると共に、資本参加やアライアンス等を積極的に行い、新たなコア事業の開発、事業領域の拡大に注力して参ります。

さらに、半導体製造装置やバイオ関連製品などの事業分野においては、市場ニーズをタイムリーに製品開発へ結び付けることが重要であり、

当社は研究開発・設備投資を積極的に推進することにより、最適なソリューションを提供する企業、いわゆる「ハイパリュウ・クリエーター」としての機能発揮を目指して参ります。

さて、当社は財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主各位に対する適正な利益の還元を利益配分の基本方針とし、配当性向40%前後を考慮に入れた配当の実施に努めております。当期末の配当につきましては、IT関連事業の市況悪化により当期純利益が業績予想から減少致しましたが、1株当たり配当金は業績予想時と同じく7円50銭とすることが決議されました。これにより、当期の配当金につきましては、既の実施した中間配当1株当たり7円50銭と合わせ、年間15円00銭の配当と致しました。

なお、当社は、日立ハイテクノロジーズとしては第1次となります「中期経営計画（平成14～16年度）」を策定し、その達成に向けてスタート致しました。今後共、当社は日立グループのハイテクノロジー事業の中核企業として、事業統合効果の早期実現に努めると共に、商社機能の強化によるハイテクノロジー事業の推進を図り、株主の皆様のご期待に沿うよう努めて参ります。

今後共、変わらぬご支援とご愛顧を引き続き賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

平成14年6月

取締役会長 **桑田 芳郎**

代表取締役
取締役社長 **樋口 紀昭**



取締役会長 桑田 芳郎



取締役社長 樋口 紀昭

事業統合により 「日立ハイテクノロジーズ」としてスタート

「平成12年度営業報告」でご案内のとおり、当社は、2001年10月1日付けで、日製産業と日立製作所の計測器・半導体製造装置グループの事業統合により「日立ハイテクノロジーズ」としてスタートしました。これにより、従来の商社機能に加えて、半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー事業に関する開発から製造、販売、サービスまでの一貫体制が整いました。



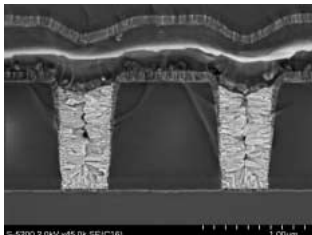
当社のナノテクノロジー事業

当社は、半導体、バイオ、材料、環境等におけるナノレベル(10億分の1m)の計測・観察・検知の領域で事業を推進しています。

微細化が進む半導体のナノレベルの線幅を測って検査する「測長SEM」(SEM:走査電子顕微鏡)は全世界でトップシェアを堅持しています。

また、「FE-SEM」は分解能(微細なものを観る性能)で常に世界をリードし、この製品も現在全世界でトップシェアです。「FE-SEM」は、次世代半導体や、ディスプレイパネルの電子源等に期待される「カーボンナノチューブ」といったナノレベルの新材料の研究・開発に活用されます。

さらに、バイオ分野では、DNAの配列を解読する「DNAシーケンサ」、DNA配列のわずかな違いを検知する「DNAチップ」等の事業を進めています。



半導体デバイスの断面

「キャピラリーアレー方式DNAシーケンサ」が 第48回大河内記念賞を受賞

当社と株式会社日立製作所は、2002年3月に「キャピラリーアレー方式DNAシーケンサの開発」に関して、財団法人大河内記念会から、第48回大河内記念賞を受賞しました。大河内記念賞は、「独創的な技術の開発及び実用化に関して特に優れた業績」に対して贈られるもので、今回、当社主任技師他4名が世界に先駆けてDNAシーケンサの研究開発を行い、実用化した業績が評価されたものです。

新型走査電子顕微鏡(SEM)2機種 (電界放出形タイプと大型試料対応タイプ) を同時発売

当社のSEMは操作性の高い形状観察・分析機器として、半導体の超微細な評価・分析をはじめ、新素材、バイオ・医療、化学、環境、エネルギー等の研究開発に貢献するなど、最先端技術分野の幅広いニーズに対応してきました。2002年2月に、電子光学系の新設計を搭載した電界放出形タイプと、これまで難しかった大型硬質試料等も観察・分析できるタイプを発売しました。



日本事業会社・ ギーゼッケ アンド デブリエント株式会社設立



当社は、Giesecke & Devrient GmbH(本社所在:ドイツ ミュンヘン)と、2002年3月に日本法人ギーゼッケ アンド デブリエント株式会社を合併で設立しました。日本事業会社の設立により、全世界で既に実績のあるGiesecke & Devrient GmbHのカード及びカードシステム製品や技術を、日本市場向け本格的に販売活動を開始しました。Giesecke & Devrient GmbHの製品開発技術力と、当社が既に日本市場にて培ってきた最先端技術分野の営業力・市場開発力の相乗効果により、カード及びカードシステム製品事業の拡大を図ります。

電子デバイスシステム部門

主要取扱品目

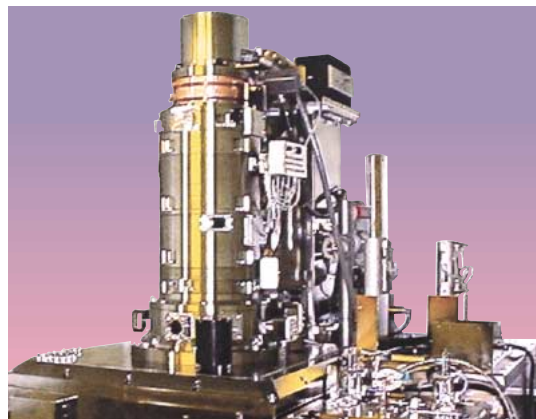
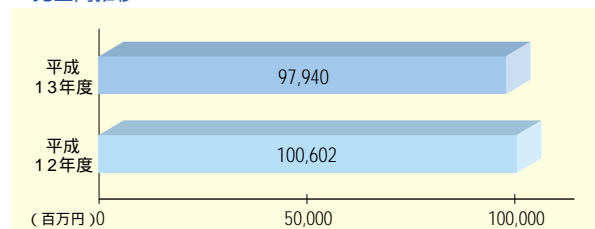
エッチング装置・電子線描画装置・縮小投影露光装置等の半導体製造装置、測長SEM・外観検査装置等の半導体製造工程検査装置、電子顕微鏡、液晶関連装置

半導体製造装置については、事業統合により新たに販売を開始した欧米向けのエッチング装置が好調に推移しました。また、新製品開発や新規顧客開拓により、電子線描画装置や外観検査装置も堅調に推移しました。

一方で、世界的な半導体業界の設備投資抑制の影響により、主力の測長SEMが大きく落ち込んだほか、国内及びアジア向けのエッチング装置も苦戦し、セグメント全体では減少となりました。

以上の結果、当部門の売上高は97,940百万円(前年同期比2.6%減)となりました。

売上高推移



電子線描画装置

ライフサイエンス部門

主要取扱品目

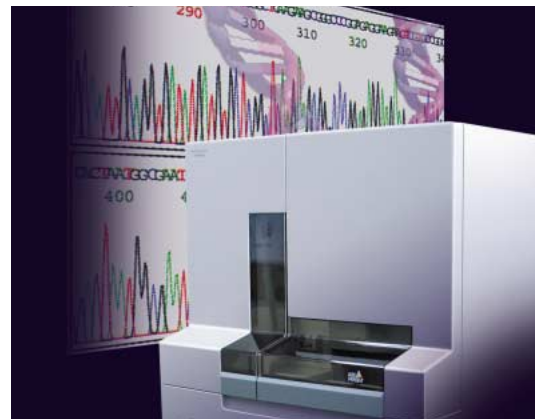
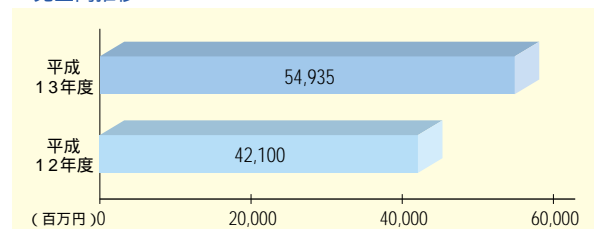
質量分析計・核磁気共鳴装置・分光光度計・クロマトグラフ・遠心機等の各種分析計測機器、バイオ関連機器、医用分析機器

医用分析装置については、欧米向けの血液自動分析装置が医療費抑制の影響を受けて減少しましたが、開発を進めている免疫自動分析装置や、新市場の中国向けは順調に推移しました。

また、事業統合により販売を開始した国内向けの医用分析装置や、米国向けのDNAシーケンサが堅調に推移し、セグメント全体では増加となりました。

以上の結果、当部門の売上高は54,935百万円(前年同期比30.5%増)となりました。

売上高推移



DNAシーケンサ

情報エレクトロニクス部門

主要取扱品目

計装機器及び関連システム、環境計測機器、自動組立システム、自動車用各種計測・検査機器、発・変電設備、研究試験設備、コンピュータシステム、ITソリューション、プリンタ・磁気記憶装置等の周辺機器、半導体・集積回路、電子管、液晶表示装置、その他各種電子部品、民生用情報家電機器

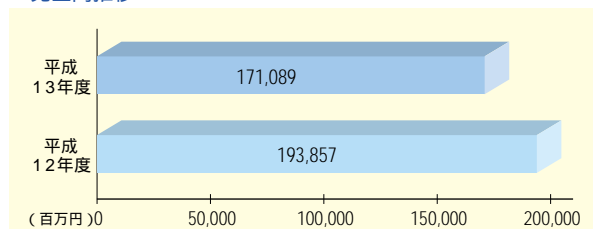
携帯電話市場の冷え込みにより、電子部品実装装置や半導体デバイスが大きく落ち込みました。

また、価格競争の厳しいカラーディスプレイ管も大幅な減少となりました。

一方で、有機EL製造装置や、DVD用ピックアップ、情報家電など携帯電話以外のIT関連製品については堅調に推移しましたが、全体の落ち込みをカバーするには至りませんでした。

以上の結果、当部門の売上高は171,089百万円(前年同期比11.7%減)となりました。

売上高推移



有機EL(エレクトロ・ルミネッセンス)製造装置

先端産業部材部門

主要取扱品目

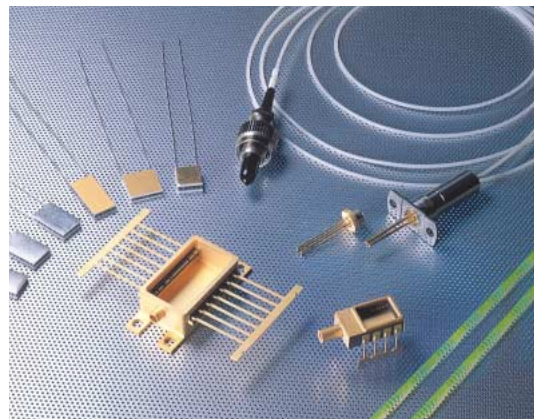
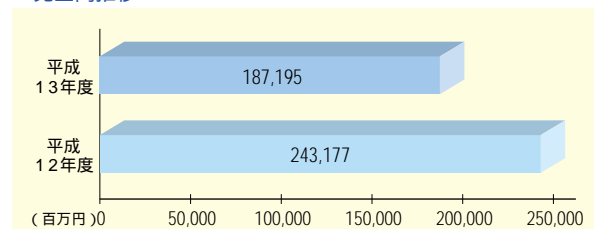
鉄鋼製品、非鉄金属製品、基板材料、合成樹脂、電子材料、液晶関連部材、光通信部材、光ストレージ部材、自動車用各種センサー、その他化成品、建設資材

世界的なIT不況の波を受け、光波長分割多重(WDM)システムなどに使われる光通信用部品が大きく落ち込んだほか、シリコンウエハーや基板材料も苦戦致しました。

PC関連製品や液晶プロジェクタ用光学部品が健闘したものの、セグメント全体では減少となりました。

以上の結果、当部門の売上高は187,195百万円(前年同期比23.0%減)となりました。

売上高推移



光通信部品

貸借対照表

科 目	当年度	前年度
	(平成14年3月31日現在)	(平成13年3月31日現在)
(資産の部)	百万円	百万円
流 動 資 産	190,090	181,406
現金及び預金	16,237	17,339
受取手形	11,811	19,630
売掛金	124,949	124,434
有価証券	2,005	4,417
商製半製品	6,985	8,421
材 料	3,241	
仕 掛 品	414	
前 渡 金	1,493	
繰延税金資産	11,170	
その他の流動資産	2,790	2,611
貸倒引当金	3,637	3,078
固 定 資 産	6,711	2,553
有形固定資産	1,358	1,081
建物	92,159	76,552
構築物	45,839	28,873
機械装置	14,661	9,004
車両運搬具	481	309
工具器具備品	7,678	226
土地	19	3
建設仮勘定	4,537	1,011
無形固定資産	18,424	18,317
営業権	36	
特許権	2,369	238
ソフトウェア	1,184	
施設利用権	83	
その他の無形固定資産	959	180
投資等	66	57
子会社株式及び出資金	76	
投資有価証券	43,951	47,439
長期貸付金	6,071	4,662
敷金保証金	28,024	35,148
繰延税金資産	1,511	3,264
その他の投資等	1,694	1,906
貸倒引当金	3,584	
	4,441	3,737
	1,376	1,279
資 産 合 計	282,249	257,958

当年度の注記

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 有価証券の評価基準及び評価方法は以下によっております。
子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法、評価差額は全部資本直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定
時価のないもの…移動平均法による原価法
- たな卸資産の評価基準及び評価方法は以下によっております。
商 品……………移動平均法による原価法
製品・半製品・材料……移動平均法による低価法
仕 掛 品……………個別法による低価法
- 有形固定資産の減価償却の方法は定率法、但しレンタル資産は定額法によっております。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法によっております。また、平成13年10月1日付で吸収分割により承継した建物については、定額法によっております。
有形固定資産の減価償却累計額 43,822百万円

科 目	当年度	前年度
	(平成14年3月31日現在)	(平成13年3月31日現在)
(負債の部)	百万円	百万円
流 動 負 債	146,633	155,394
支払手形	19,261	25,686
買掛金	82,089	108,267
短期借入金	20,000	
未払金	3,015	857
未払税金	100	4,434
未払費用	10,284	3,512
前受金	6,972	8,018
その他の流動負債	4,909	4,616
固 定 負 債	14,110	8,433
繰延税金負債		907
退職給付引当金	13,567	7,026
役員退職慰労引当金	543	500
負 債 合 計	160,743	163,828
(資本の部)		
資 本	7,938	5,438
法定準備金	37,082	11,054
資本準備金	35,723	9,695
利益準備金	1,359	1,359
剰 余 金	72,078	71,048
別途積立金	66,500	64,800
当期末処分利益	5,578	6,248
(うち当期利益)	(3,313)	(5,562)
評価差額金	4,517	6,587
その他有価証券評価差額金	4,517	6,587
自 己 株 式	111	
資 本 合 計	121,506	94,130
負 債 及 び 資 本 合 計	282,249	257,958

- リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- 退職給付引当金は、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- 役員退職慰労引当金については、商法第287条ノ2に規定する引当金であります。
- 有価証券の時価評価により、純資産額が4,517百万円増加しております。
なお、当該金額は商法第290条第1項第6号の規定により、配当に充当することが制限されております。
- 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
- 親会社短期金銭債権 15,571百万円
- 親会社短期金銭債務 19,093百万円
- 子会社短期金銭債権 23,769百万円
- 子会社短期金銭債務 15,622百万円
- 保証債務 2,235百万円
- 輸出手形割引高 5,136百万円
- 受取手形裏書譲渡高 184百万円
- 1株当たり当期利益 29円91銭

単独決算

損益計算書

科 目	当年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)	前年度 (平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで)
(経常損益の部)	百万円	百万円
営業損益の部		
売上高	511,160	579,738
売上原価	462,430	541,327
販売費及び一般管理費	43,962	28,934
営業利益	4,768	9,476
営業外損益の部		
営業外収益	2,469	2,026
受取利息	604	914
受取配当金	1,084	995
雑収益	780	115
営業外費用	1,517	962
支払利息	140	118
雑損失	1,376	843
経常利益	5,720	10,540
(特別損益の部)		
特別利益		1,990
土地売却益		1,990
特別損失		2,728
退職給付会計基準変更時差異償却額		2,728
税引前当期利益	5,720	9,801
法人税、住民税及び事業税	2,039	6,641
法人税等調整額	368	2,402
当期利益	3,313	5,562
前期中間繰越利益	2,923	1,782
中間配当額	658	1,096
当期未処分利益	5,578	6,248

当年度の注記

親会社との取引高

売上高	93,581百万円
仕入高	104,704百万円
営業取引以外の取引高	2,206百万円

子会社との取引高

売上高	83,005百万円
仕入高	47,117百万円
営業取引以外の取引高	5,539百万円

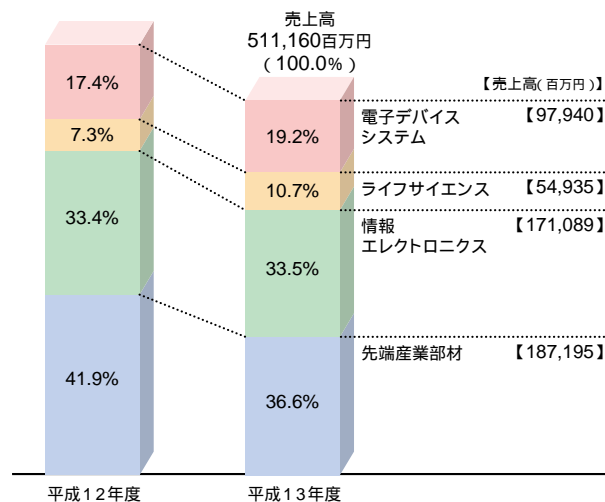
利益処分

当期未処分利益	円 5,578,899,953
これを下記のとおり処分します。	
利益配当金	1,032,489,233
1株につき7円50銭 (普通配当7円50銭)	
取締役賞与金	100,000,000
別途積立金	2,300,000,000
次期繰越利益	2,146,410,720

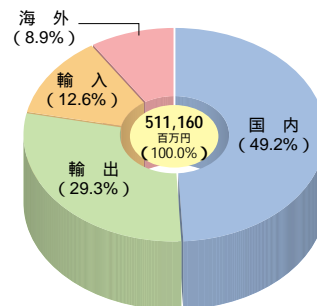
- (注) 1. 平成13年12月3日に1株につき7円50銭の中間配当を実施しました。
2. 利益配当金は自己株式73,499株分を除いております。

売上高の状況

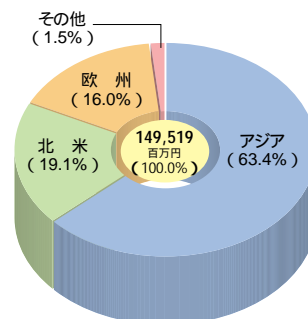
セグメント別売上高



取引形態別売上高 (平成13年度)



地域別輸出売上高 (平成13年度)



経営指標の推移

科 目	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度
経営成績				
売上高 (百万円)	549,708	539,217	579,738	511,160
経常利益 (百万円)	7,538	7,711	10,540	5,720
当期利益 (百万円)	3,815	4,366	5,562	3,313
1株当たり当期利益 (円)	42.73	49.03	63.40	29.91
株主資本当期利益率 (%)	4.8	5.3	6.2	3.1
売上高経常利益率 (%)	1.4	1.4	1.8	1.1
財政状態				
総資産 (百万円)	217,645	231,362	257,958	282,249
株主資本 (百万円)	79,991	84,481	94,130	121,506
株主資本比率 (%)	36.8	36.5	36.5	43.0
1株当たり株主資本 (円)	895.88	962.88	1,072.85	882.62
資本金 (百万円)	5,438	5,438	5,438	7,938
発行済株式総数 (千株)	89,289	87,739	87,739	137,739
配当状況				
1株当たり年間配当金 (円)	20.00	25.00	30.00	15.00
配当性向 (%)	46.8	50.6	47.3	51.0
その他従業員数 (人)	1,408	1,388	1,375	3,130

平成11年度

当年度における世界経済は、米国が引き続き高成長を持続して戦後最長の景気拡大を記録したほか、欧州経済も生産活動の回復を受けた内需主導の緩やかな成長を遂げました。不振を続けていたアジア経済も輸出の大幅な拡大により回復が鮮明なものとなりました。

一方、わが国経済は、設備投資が2年連続でマイナスとなったものの、輸出の拡大や政策効果による住宅投資の拡大に相俟って僅かながらプラスに転じました。

このような経営環境の中にあつて当社は、最先端技術分野を中心とした成長分野でのグローバルな開発を重点的に進めると同時に、激変する事業環境に対応するため、経営のスピードアップや高効率化に努めて参りました。

この結果、当年度の業績は前年度比較で売上高1.9%減、経常利益2.3%増、当期利益14.4%増となりました。

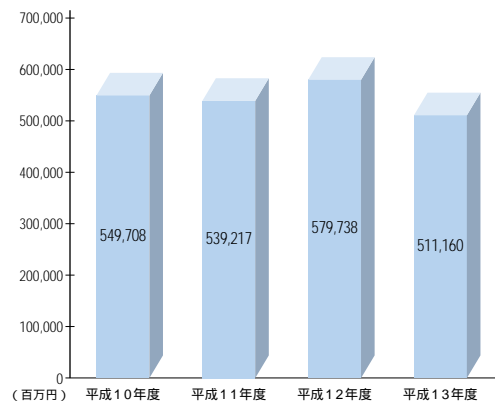
平成12年度

当年度における世界経済は、2000年後半に入り、これまで世界経済を牽引してきた米国経済の成長鈍化が明らかになったものの、欧州、アジア経済は低水準ながらも比較的堅調に推移しました。また、日本経済は、移動体通信やデジタル家電などIT関連を中心に民間設備投資の一部に活発な動きが見られましたが、依然として雇用環境は厳しく、個人消費は低迷した状況が続きました。

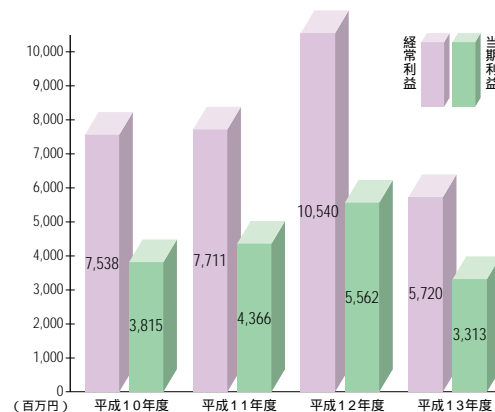
このような経営環境の中にあつて当社は、半導体や情報通信などの成長分野に経営資源を集中投入すると共に、競争力ある新規事業の開発を推進して参りました。

この結果、当年度の業績は前年度比較で、売上高7.5%増、営業利益50.1%増、経常利益36.7%増、当期純利益27.4%増となり、売上高、収益共に前年度を上回り、特に営業利益、当期純利益は過去最高となりました。

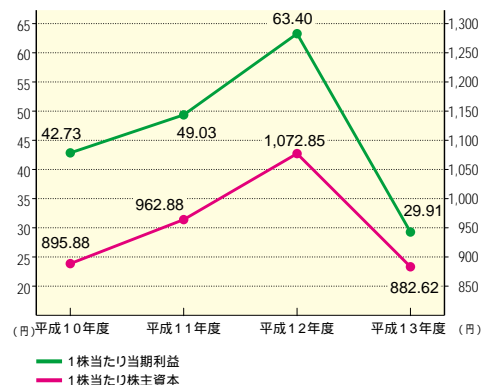
売上高



経常利益・当期利益



1株当たり当期利益・1株当たり株主資本

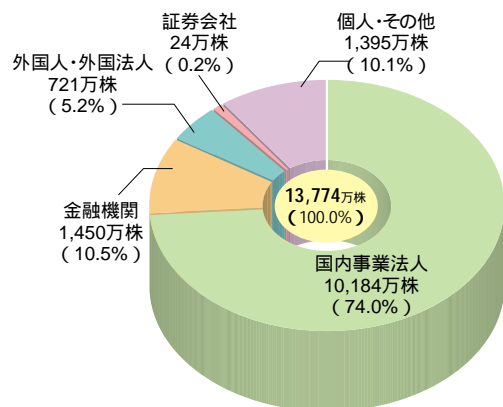


株式の状況

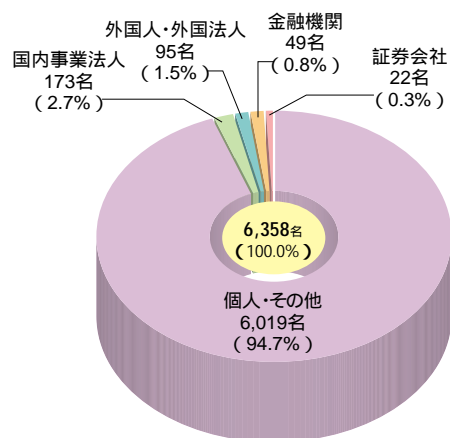
株式の状況（平成14年3月31日現在）

発行済株式総数	137,738,730株
株主数	6,358名
当年度株式移動状況	
名義書換件数	621件
名義書換株式数	9,167,825株

株式分布状況（平成14年3月31日現在）



所有者別株式分布状況(株数)

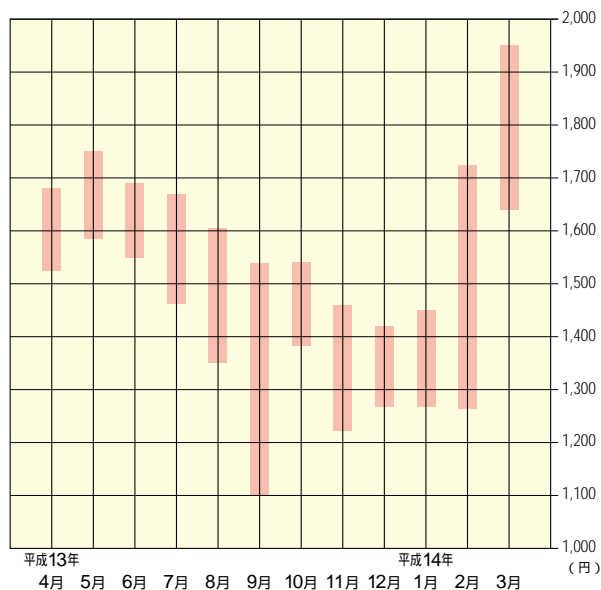


所有者別株式分布状況(株主数)

大株主（平成14年3月31日現在）

株主名	持株数	持株比率
株式会社日立製作所	99,607,382株	72.3%
ザチェースマンハッタンバンク	2,765,000株	2.0%
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	2,735,000株	2.0%
日立ハイテクノロジー社員持株会	2,522,978株	1.8%
三菱信託銀行株式会社	2,241,000株	1.6%
資産管理サービス 信託銀行株式会社	1,962,000株	1.4%
三井アセット信託銀行株式会社	1,609,000株	1.2%
株式会社富士銀行	1,464,021株	1.1%
農中信託銀行株式会社	914,000株	0.7%
UFJ信託銀行株式会社	902,624株	0.7%

株価の推移（東京証券取引所における市場相場）



連結貸借対照表

科 目	当年度 (平成14年3月31日現在)	前年度 (平成13年3月31日現在)
(資産の部)	百万円	百万円
流動資産	274,386	268,810
現金及び預金	43,193	43,563
受取手形及び売掛金	177,127	193,240
有価証券	2,098	4,417
たな卸資産	37,448	18,407
繰延税金資産	8,036	5,079
前渡金	2,917	2,813
その他の貸倒引当金	5,663	3,180
	2,095	1,889
固定資産	108,147	86,085
有形固定資産	56,584	32,619
建物及び構築物	19,436	10,407
機械装置及び運搬具	8,854	351
工具器具備品	6,616	2,247
土地	20,842	19,614
建設仮勘定	836	
無形固定資産	3,187	387
営業権及び特許権	1,371	
ソフトウェア	1,574	272
その他	241	115
投資その他の資産	48,376	53,079
投資有価証券	31,328	41,027
長期貸付金	1,817	3,557
その他の繰延税金資産	8,523	7,248
繰延税金資産	8,137	2,582
貸倒引当金	1,429	1,335
資産合計	382,533	354,895

科 目	当年度 (平成14年3月31日現在)	前年度 (平成13年3月31日現在)
(負債の部)	百万円	百万円
流動負債	199,766	223,422
支払手形及び買掛金	129,371	188,790
短期借入金	29,425	2,557
未払法人税等	2,805	7,082
未払費用	19,416	6,920
前受金	9,579	12,236
その他の負債	9,172	5,837
固定負債	24,566	14,048
繰延税金負債		907
退職給付引当金	23,283	12,246
役員退職慰労引当金	1,157	895
その他の負債	126	
負債合計	224,332	237,470
(少数株主持分)		
少数株主持分	3,047	205
(資本の部)		
資本金	7,938	5,438
資本準備金	35,723	9,695
連結剰余金	106,733	96,084
その他有価証券評価差額金	4,581	6,645
為替換算調整勘定	290	639
自己株式	111	3
資本合計	155,154	117,220
負債、少数株主持分及び資本合計	382,533	354,895

連結損益計算書

科 目	当年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)	前年度 (平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで)
	百万円	百万円
売上高	738,289	848,700
売上総利益	662,257	787,632
売上総利益	76,032	61,068
販売費及び一般管理費	66,092	46,380
営業利益	9,940	14,688
営業外収益	2,268	3,153
受取利息	1,047	1,763
受取配当金	160	154
持分法による投資利益	159	863
雑収益	902	373
営業外費用	1,887	1,449
支払利息	183	146
雑損	1,703	1,303
経常利益	10,321	16,392
特別利益		1,990
土地売却益		1,990
特別損失		4,612
退職給付会計基準変更時差異償却額		4,612
税金等調整前当期純利益	10,321	13,770
法人税、住民税及び事業税	4,574	9,717
法人税等調整額	108	3,662
少数株主利益	132	24
当期純利益	5,507	7,691

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

科 目	当年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)	前年度 (平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	10,321	13,770
減価償却費	4,882	1,966
退職給与引当金の減少額		6,284
退職給付引当金の増減額	317	12,246
各種引当金の増減額	10	1,297
受取利息及び受取配当金	1,207	1,917
支払利息	183	146
土地売却益		1,990
その他の収益・費用の非資金分	402	551
役員賞与の支払額	233	180
売上債権の増減額	47,784	30,079
たな卸資産の増減額	3,732	5,419
仕入債務の増減額	68,691	22,241
その他の資産及び負債の増減額	3,594	511
その他の	467	18
小計	27	4,717
利息及び配当金の受取額	1,277	1,941
利息の支払額	175	146
法人税等の支払額	9,898	5,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,824	1,097
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	382	483
定期預金の払出による収入	568	
有価証券の取得による支出	101	1,999
有価証券の売却による収入	4,509	3,273
投資有価証券の取得による支出	184	8,059
投資有価証券の売却による収入	1,814	2,000
有形・無形固定資産の取得による支出	5,204	2,065
有形・無形固定資産の売却による収入	56	2,233
貸付による支出	530	1,500
貸付の回収による収入		1,000
その他の投資の取得による支出		200
その他の投資の売却による収入		1,820
投資活動によるキャッシュ・フロー	547	3,980
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	3,450	1,233
配当金の支払額	2,193	2,413
その他の	117	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,139	3,653
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,379	1,271
現金及び現金同等物の減少額	5,759	5,265
現金及び現金同等物の期首残高	42,995	48,260
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,814	
吸収分割による連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,759	
現金及び現金同等物の期末残高	42,811	42,995

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の は、現金及び現金同等物の流出を示しております。

連結貸借対照表の現金及び預金残高と連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物期末残高との調整

(単位 百万円)

現金及び預金	43,193	43,563
預入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	382	568
現金及び現金同等物	42,811	42,995

グループ会社一覧

当社の連結対象会社は下記のとおり31社であります。

重要な連結子会社

会社名	資本金	主な事業内容
日立計測器サービス株式会社	1,000百万円	科学機器・工業計器等の据付保守サービス
株式会社日製エレクトロニクス	300百万円	情報機器・電子部品等の販売
株式会社日製メックス	200百万円	化学製品・電子材料等の販売
日製エンジニアリング株式会社	100百万円	計装・FAに関するエンジニアリング機器の販売
株式会社日立サイエンスシステムズ	400百万円	汎用科学機器・小形医用機器の製造及びソフトウェアの開発・製作、関連する技術を用いた受託分析
日立那珂エレクトロニクス株式会社	200百万円	計測制御システム・計測制御機器・検体検査システムの製造、那珂事業所関連製品の原料・部品製作
那珂インストルメンツ株式会社	180百万円	分析装置・医用機器用ユニットの製造、精密金型及び成形品の生産
アメリカ日製産業Ltd.	12,000千米ドル	電子部品・情報機器・科学機器等の販売
ドイツ日製産業G.m.b.H.	2,556千ユーロ	情報機器・科学機器・電子部品等の販売
シンガポール日製産業Pte.Ltd.	4,000千シンガポールドル	電子部品・産業機械・工業材料等の販売
日製産業香港有限公司	15,000千香港ドル	産業機械・情報機器・電子部品・工業材料等の販売

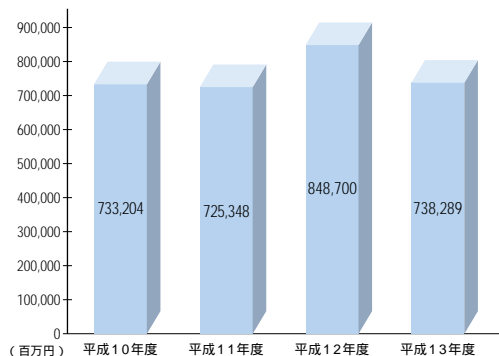
その他の連結子会社

日製電機株式会社	上海日製産業有限公司
日製ソフトウェア株式会社	韓国ヒスコ Ltd.
日製サービス株式会社	亞太日立計測器服務股份有限公司
株式会社日製サイエンス	株式会社テラウイン
カナダ日製産業 Inc.	ヒスコソリューション株式会社
フランス日製産業 S.A.R.L.	計測テクノロジー株式会社
マレーシア日製産業 IPC Sdn.Bhd.	日立インストルメンツ Inc.
タイランド日製産業 Co.,Ltd.	ヨーロッパヒスコ G.m.b.H.
日製三洋ハイテクサービス Pte.Ltd.	日立インストルメンツイスラエル Ltd.
ブラジル日製産業 Ltda.	日立儀器(蘇州)有限公司

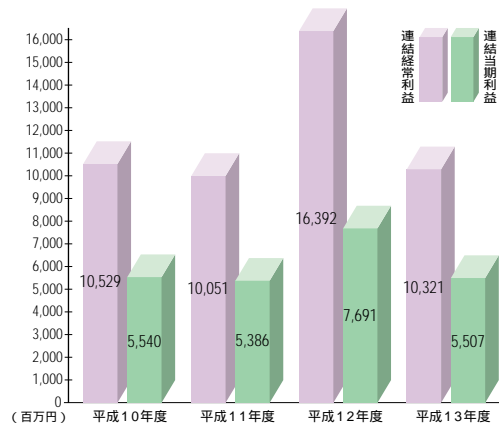
連結経営指標の推移

科 目	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度
経営成績				
連結売上高 (百万円)	733,204	725,348	848,700	738,289
連結経常利益 (百万円)	10,529	10,051	16,392	10,321
連結当期利益 (百万円)	5,540	5,386	7,691	5,507
連結1株当たり当期利益 (円)	62.05	60.49	87.66	49.71
連結株主資本当期利益率 (%)	5.8	5.3	6.9	4.0
連結売上高経常利益率 (%)	1.4	1.4	1.9	1.4
財政状態				
連結総資産 (百万円)	283,713	305,483	354,895	382,533
連結株主資本 (百万円)	98,091	106,173	117,220	155,154
連結株主資本比率 (%)	34.6	34.8	33.0	40.6
連結1株当たり株主資本 (円)	1,098.62	1,210.15	1,336.04	1,127.04

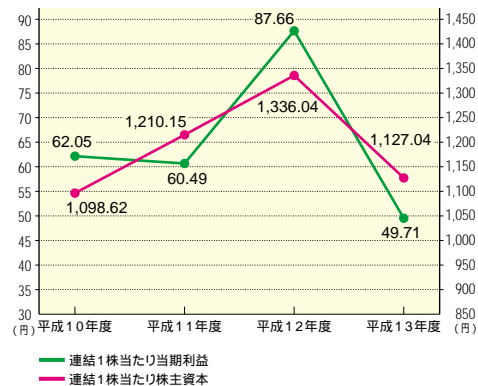
連結売上高



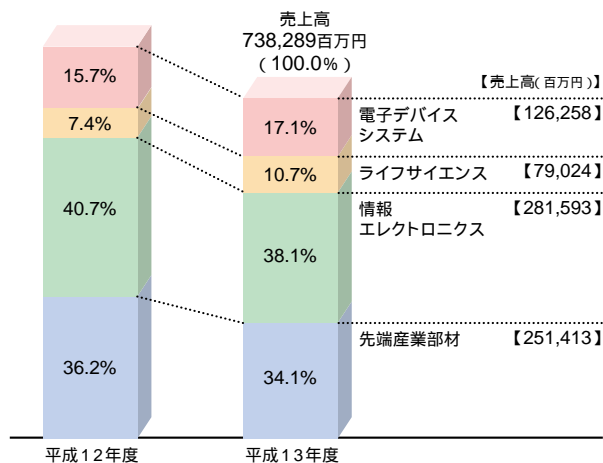
連結経常利益・連結当期利益



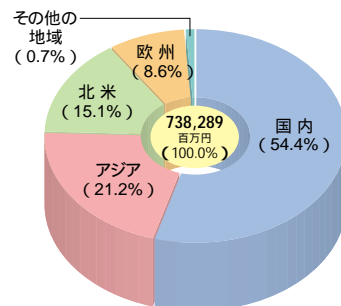
連結1株当たり当期利益・連結1株当たり株主資本



連結セグメント別売上高



連結仕向地別売上高 (平成13年度)



国内事業所

本社

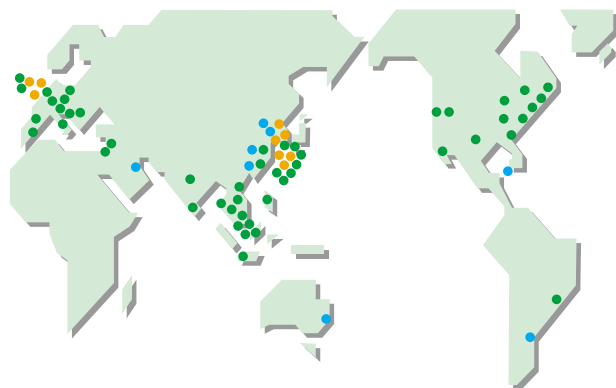
〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号

事業所及び支店

那珂事業所、笠戸事業所、北海道支店、東北支店、
茨城支店、筑波支店、中部支店、関西支店、
中国支店、九州支店

営業所及び出張所

北陸営業所、高崎営業所、横浜営業所、
栃木営業所、豊田営業所、浜松営業所、
京都営業所、四国営業所、南九州営業所、
茂原出張所



海外事業所

支店

ロンドン支店、台北支店、ソウル支店

出張所

ハバチ出張所、プエノスアイレス出張所、クウェート出張所、北京出張所、
上海出張所、広州出張所、大連出張所、シドニー出張所

海外グループ会社

株主メモ

決算期	毎年3月末日
定時株主総会	毎年6月
公告掲載新聞	日本経済新聞
決算公告掲載ホームページアドレス	http://www.hitachi-hitec.com/
配当金受領株主確定日	利益配当金 毎年3月末日 中間配当金 毎年9月末日
名義書換代理人	東京証券代行株式会社
同上事務取扱場所	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 (新丸ビル7階)
上場証券取引所	電話(03)3212-4611(代表) 東京・大阪証券取引所(市場第一部)

A young girl with dark hair, wearing a pink polka-dot shirt and a black skirt, stands on a brown floor, pointing her right index finger upwards. She is looking up at a massive wall that is completely covered in a dense, colorful array of various flowers, including roses, lilies, and daisies in shades of pink, red, yellow, and white. The flowers are so numerous and vibrant that they fill the entire background of the upper half of the image.

咲きます。
ハイテク・ソリューション。

「日立ハイテクノロジーズ」は日製産業のグローバルな営業力と
日立製作所の世界トップレベルの技術力が結びついて誕生しました。

従来の商社機能に加え、ライフサイエンス・半導体製造の分野では開発・設計から
製造・販売・サービスまで一貫体制でお客様への最適なソリューションをご提供いたします。

「日立ハイテクノロジーズ」は、ナノテクノロジーに代表される最先端技術分野をはじめ、
エレクトロニクスの川上から川下まで、幅広いビジネスフィールドで
21世紀のハイテク・ソリューションの花を咲かせます。

株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号

電話:(03)3504-7111 <http://www.hitachi-hitec.com/>

事業所数: 世界25ヵ国 国内事業所 21ヵ所 海外事業所 68ヵ所

事業分野: デバイス製造装置/ライフサイエンス/情報・生産/電子部品/先端産業部材